

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Applicant: I-Chun CHEN,                    ) Group: Not yet assigned  
  ) et al.                                    )  
Serial No.: Not yet assigned                )  
Filed: Concurrently herewith                ) Examiner: Not yet assigned  
  ) Our Ref: B-5216 621175-6  
For: "HOUSING STRUCTURE"                    ) Date: August 27, 2003

CLAIM TO PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119

Mail Stop Patent Application  
Commissioner for Patents  
P.O. Box 1450  
Alexandria, VA 22313-1450

Sir:

[X] Applicants hereby make a right of priority claim under 35  
U.S.C. 119 for the benefit of the filing date(s) of the  
following corresponding foreign application(s):

<u>COUNTRY</u>	<u>FILING DATE</u>	<u>SERIAL NUMBER</u>
Taiwan, R.O.C.	21 February 2003	92202747

[ ] A certified copy of each of the above-noted patent  
applications was filed with the Parent Application  
No. \_\_\_\_\_.

[X] To support applicant's claim, a certified copy of the above-  
identified foreign patent application is enclosed herewith.

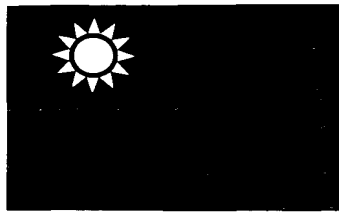
[ ] The priority document will be forwarded to the Patent Office  
when required or prior to issuance.

Respectfully submitted,



Richard P. Berg  
Attorney for Applicant  
Reg. No. 28,145

LADAS & PARRY  
5670 Wilshire Boulevard  
Suite 2100  
Los Angeles, CA 90036  
Telephone: (323) 934-2300  
Telefax: (323) 934-0202



# 中華民國經濟部智慧財產局

INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE  
MINISTRY OF ECONOMIC AFFAIRS  
REPUBLIC OF CHINA

茲證明所附文件，係本局存檔中原申請案的副本，正確無訛，  
其申請資料如下：

This is to certify that annexed is a true copy from the records of this  
office of the application as originally filed which is identified hereunder:

申請日：西元 2003 年 02 月 21 日  
Application Date

申請案號：092202747  
Application No.

申請人：緯創資通股份有限公司  
Applicant(s)

局 長

Director General

蔡 練 生

發文日期：西元 2003 年 4 月 30 日  
Issue Date

發文字號：09220428680  
Serial No.

申請日期：	IPC分類
申請案號：	

(以上各欄由本局填註)

# 新型專利說明書

一、 新型名稱	中 文	殼體結構
	英 文	
二、 創作人 (共1人)	姓 名 (中文)	1. 陳宜君
	姓 名 (英文)	1. I-Chun, Chen
	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
	住居所 (中 文)	1. 台北縣汐止市新台五路一段88號21樓
	住居所 (英 文)	1.
三、 申請人 (共1人)	名稱或 姓 名 (中文)	1. 緯創資通股份有限公司
	名稱或 姓 名 (英文)	1. Wistron Corporation
	國 籍 (中英文)	1. 中華民國 TW
	住居所 (營業所) (中 文)	1. 台北縣汐止市新台五路一段八十八號二十一樓 (本地址與前向貴局申請者相同)
	住居所 (營業所) (英 文)	1.
	代表人 (中文)	1. 林憲銘
	代表人 (英文)	1.



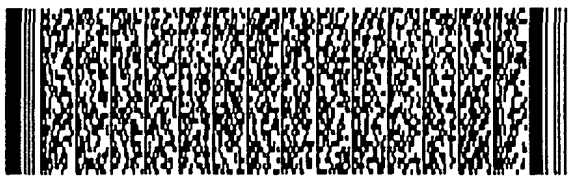
#### 四、中文創作摘要 (創作名稱：殼體結構)

一種殼體結構，該殼體結構包括一殼體本體以及至少一支承構件，其中支承構件可於一第一位置與一第二位置之間移動的方式設置於殼體本體上。殼體本體具有至少一第一定位部，而支承構件具有至少一第二定位部，且第一定位部係耦接於第二定位部。其中支承構件於第一位置時，殼體本體係具有一第一支承底面，而支承構件於第二位置時，殼體本體係具有一第二支承底面，其中第二支承底面係大於第一支承底面。如此一來，當支承構件於第二位置時，殼體結構便可在支承構件的支承下達到良好的穩定度。

伍、(一)、本案代表圖為：第\_\_\_3B\_\_\_圖

(二)、本案代表圖之元件代表符號簡單說明：

#### 英文創作摘要 (創作名稱：)



四、中文創作摘要 (創作名稱：殼體結構)

- 1 ~ 殼體本體；
- 2 ~ 支承構件；
- 2-1 ~ 第一構件；
- 2-2 ~ 第二構件。

英文創作摘要 (創作名稱：)



一、本案已向

國家(地區)申請專利

申請日期

案號

主張專利法第一百零五條準用  
第二十四條第一項優先權

二、☐主張專利法第一百零五條準用第二十五條之一第一項優先權：

申請案號：

日期：

三、主張本案係符合專利法第九十八條第一項☐第一款但書或☐第二款但書規定之期間

日期：



## 五、創作說明 (1)

### 新型所屬之技術領域

本新型係有關於一種殼體結構，特別有關一種藉由增加底部接觸面積以達到良好穩定性之殼體結構。

### 先前技術

就目前大多數的電子裝置【例如：遊戲機、外接式儲存設備(硬碟、光碟機等)】而言，部分的設計採取矩型狀的殼體結構。當欲進行該電子裝置之直立式放置時，其方式係多半在其底部加裝另一單件式承座或其它類似元件以對於該電子裝置進行支承，如此以防止不當外力所可能造成的傾倒。

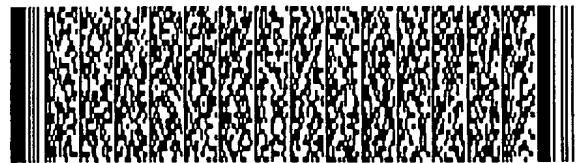
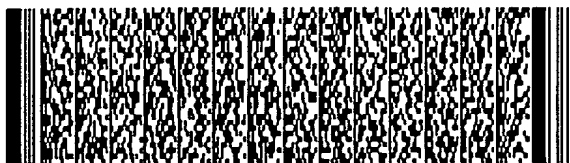
然而，由於此一承座或其它類似元件係為一單件式元件，雖然該承座是採取可分離方組合於該電子裝置之上，但卻也容易造成該承座的遺失。

### 新型內容

有鑑於此，本新型之目的係在於提供一種具有支承構件之殼體結構，藉由該支承構件以增加該殼體結構之穩定性。

本新型之另一目的係在於提供一種具有整體性之殼體結構，藉由該支承構件的合併方式的組合效果下，使用者係可根據操作環境的需求而可將該支承構件進行延伸，如此以達到穩定性支承的效果。

為達成上述目的，本新型提供一種殼體結構，該殼體



## 五、創作說明 (2)

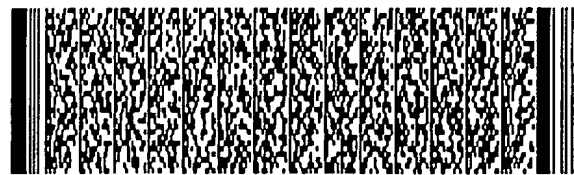
結構包括一殼體本體，具有至少一第一定位部；至少一支承構件，以可於一第一位置與一第二位置之間移動的方式設置於該殼體本體上，該支承構件具有至少一第二定位部，該第一定位部係耦接於該第二定位部，該支承構件於該第一位置時，該本體係具有一第一支承底面，該支承構件於該第二位置時，該本體係具有一第二支承底面，該第二支承底面係大於該第一支承底面。其中該殼體本體係可為一矩型構件，該第一定位部係可為一導槽，而該第二定位部係可為一導塊。又，該支承構件更包括有一第一構件與一第二構件，其中該第一構件、該第二構件之間係沿著相反方向而由該第一位置移動至該第二位置。

當該支承構件於該第二位置時，由於實際的接觸面積增加，因而造成該殼體結構之整體結構的重心降低，如此可使得該殼體結構具有良好的穩定性。

為了讓本新型之上述和其他目的、特徵、和優點能更明顯易懂，下文特舉一較佳實施例，並配合所附圖示，作詳細說明如下：

### 實施方式

請參閱第1A、1B圖，第1A、1B圖係分別表示依據本新型一實施例所提出的殼體結構於兩種不同狀態下之立體圖，其中，該殼體結構係以倒置的方式進行設置。該殼體結構包括一殼體本體1與一支承構件2，其中，該殼體本體1內部係可容納一電子裝置【例如：遊戲機、硬碟、光碟





### 五、創作說明 (3)

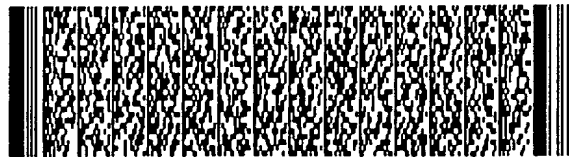
機等】(但未圖示)，該支承構件2係由一第一構件2-1與一第二構件2-2所組成，該第一構件2-1與該第二構件2-2係以可移動方式設置於該殼體本體1之一側邊上，該第一構件2-1、該第二構件2-2係可於一第一位置I-I與一第二位置II-II之間進行移動。

於第1A圖中之該第一構件2-1與該第二構件2-2係呈現出未伸展狀態，亦即，此時該第一構件2-1、該第二構件2-2係處於該第一位置I-I；於第1B圖中之該第一構件2-1與該第二構件2-2係呈現出完全伸展狀態，亦即，此時該第一構件2-1、該第二構件2-2係處於該第二位置II-II。

第2圖係表示根據第1A、1B圖中之該殼體結構的分解立體圖。

該殼體本體1係為一矩型構件，於該殼體本體1之一側邊100係形成有複數第一定位部10、11、12，其中，該第一定位部10、11、12係以相互間隔方式並列於該側邊100之上。於本實施例中，該第一定位部10、11、12係為形成於該側邊100上的複數導槽。

該第一構件2-1與該第二構件2-2係為近似L型狀之板狀構件。該第一構件2-1係由相互垂直之兩板件211、212所構成，而該第二構件2-2係由相互垂直之兩板件221、222所構成，並且於該第一構件2-1之板件212上、該第二構件2-2之板件222上分別凸出設置有1個第二定位部20及2個第二定位部21、22。各第二定位部20、21、22係用以做為導塊之使用，其中，該第二定位部20係用以耦合於該第



#### 五、創作說明 (4)

一定位部10，而該第二定位部21(22)係用以分別耦合於該第一定位部11(12)。

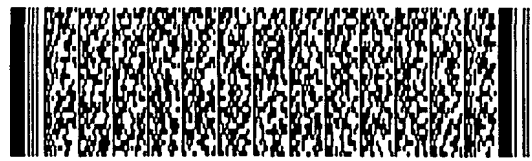
如此一來，該第一構件2-1係可藉由耦合該第二定位部20與該第一定位部10二者，而於該二者之間進行往復移動，並且該第二構件2-2係可藉由耦合該第二定位部21(22)與該第一定位部11(12)二者，而於該二者之間進行往復移動，亦即如上所述之可在該第一位置I-I與該第二位置II-II之間進行移動。

請參閱第3A、3B圖。

第3A圖係表示當該支承構件2【該第一構件2-1、該第二構件2-2】位於由第一位置I-I時，藉由該支承構件2鄰接於平台(W)以對於該殼體本體1進行支承時之立體圖，而第3B圖則表示當該支承構件2【該第一構件2-1、該第二構件2-2】位於由第二位置II-II時，藉由該支承構件2鄰接於平台(W)以對於該殼體本體1進行支承時之立體圖。

請再請參閱第1A、1B圖。符號A1係表示該第一構件2-1之實際支承底面，符號A2則表示該第二構件2-2之實際支承底面。

當該支承構件2處於該第一位置I-I(如第1A圖所示)時，該殼體本體1係具有一第一支承底面(A1+A2)，於第3A圖中所示之該殼體本體1係藉由該第一支承底面(A1+A2)鄰接於其所接觸之平台W。當該支承構件2處於該第二位置II-II(如第1B圖所示)時，該殼體本體1則具有一第二支承底面(A1+A2+B1+B2+B3)，於第3B圖中所示之該殼體本體1



##### 五、創作說明 (5)

係藉由該第二支承底面( $A1+A2+B1+B2+B3$ )鄰接於其所接觸之平台W，其中，符號B1、B2、B3係表示當該支承構件2由第一位置I-I移動至第二位置II-II時所另外增加的有效面積，亦即，第二支承底面( $A1+A2+B1+B2+B3$ )大於該第一支承底面( $A1+A2$ )。

由此可知，當該支承構件2處於該第二位置II-II時，該殼體本體1之底部面積增大，因而造成該殼體本體1之整體結構的重心降低，如此可使得該殼體結構具有良好的穩定性。

雖然本新型已以較佳實施例揭露如上，然其並非用以限制本新型，任何熟習此項技藝者，在不脫離本新型之精神和範圍內，當可做更動與潤飾，因此本新型之保護範圍當事後附之申請專利範圍所界定者為準。



#### 圖式簡單說明

第1A圖係表示依據本新型一實施例所提出的殼體結構之立體圖，其中，該主機結構係呈現倒置狀態；

第1B圖係表示第1A圖中之該殼體結構於另一狀態下之立體圖；

第2圖係表示根據第1A、1B圖中之該殼體結構的分解立體圖；

第3A圖係表示根據第1A圖中之該殼體結構呈現直立狀態下之立體圖，其中，該殼體結構係置放於一平台(W)之上；

第3B圖係表示第3A圖中之該殼體結構於另一狀態下之立體圖。

#### 符號說明

1~殼體本體；

10、11、12~第一定位部；

100~側邊；

2~支承構件；

20、21、22~第二定位部；

2-1~第一構件；

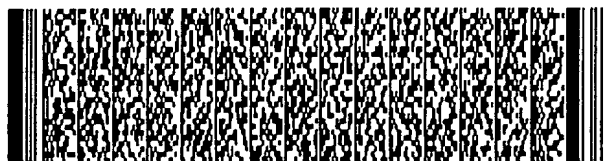
211、212~板件；

2-2~第二構件；

221、222~板件；

A1~第一構件2-1之實際支承底面；

A1+A2~第一支承底面；



圖式簡單說明

$A1+A2+B1+B2+B3$ ~ 第二支承底面；

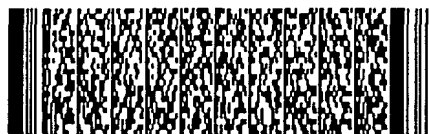
$A2$ ~ 第二構件2-2之實際支承底面；

$B1$ 、 $B2$ 、 $B3$ ~ 有效面積；

I-I~ 第一位置；

II-II~ 第二位置；

W~ 平台。



## 六、申請專利範圍

1. 一種電子裝置之殼體結構，包括：

一殼體本體，具有至少一第一定位部；

至少一支承構件，以可於一第一位置與一第二位置之間移動的方式設置於該殼體本體上，該支承構件具有至少一第二定位部，該第一定位部係耦接於該第二定位部，該支承構件於該第一位置時，該殼體本體係具有一第一支承底面，該支承構件於該第二位置時，該殼體本體係具有一第二支承底面，該第二支承底面係大於該第一支承底面。

2. 如申請專利範圍第1項所述之電子裝置之殼體結構，其中，該殼體本體係為一矩型構件。

3. 如申請專利範圍第1項所述之電子裝置之殼體結構，其中，該第一定位部係為一導槽。

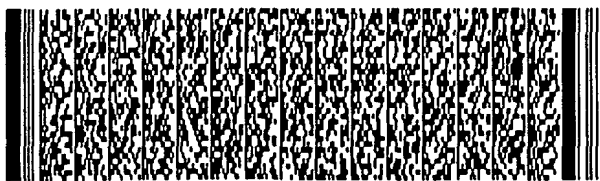
4. 如申請專利範圍第1項所述之電子裝置之殼體結構，其中，該第二定位部係為一導塊。

5. 如申請專利範圍第1項所述之電子裝置之殼體結構，其中，該支承構件更包括有一第一構件與一第二構件，該第一構件、該第二構件之間係沿著相反方向而由該第一位置移動至該第二位置。

6. 一種殼體結構，包括：

一殼體本體，具有至少一第一定位部；

至少一支承構件，以可於一第一位置與一第二位置之間移動的方式設置於該殼體本體上，該支承構件具有至少一第二定位部，該第一定位部係耦接於該第二定位部，該支承構件於該第一位置時，該殼體本體係具有一第一支承



## 六、申請專利範圍

底面，該支承構件於該第二位置時，該殼體本體係具有一第二支承底面，該第二支承底面係大於該第一支承底面。

7. 如申請專利範圍第6項所述之殼體結構，其中，該殼體本體係為一矩型構件。

8. 如申請專利範圍第6項所述之殼體結構，其中，該第一定位部係為一導槽。

9. 如申請專利範圍第6項所述之殼體結構，其中，該第二定位部係為一導塊。

10. 如申請專利範圍第6項所述之殼體結構，其中，該支承構件更包括有一第一構件與一第二構件，該第一構件、該第二構件之間係沿著相反方向而由該第一位置移動至該第二位置。

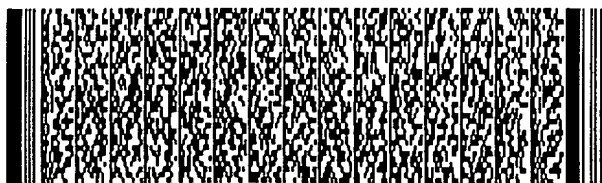
11. 一種殼體結構，包括：

一殼體本體，具有至少一第一定位部；

一第一構件與一第二構件，以可於一第一位置與一第二位置之間移動的方式設置於該殼體本體上，該第一構件、該第二構件均具有至少一第二定位部，該第一定位部係耦接於該第二定位部，該第一構件及該第二構件於該第一位置時，該殼體本體係具有一第一支承底面，該第一構件、該第二構件於該第二位置時，該殼體本體係具有一第二支承底面，該第二支承底面係大於該第一支承底面。

12. 如申請專利範圍第11項所述之殼體結構，其中，該殼體本體係為一矩型構件。

13. 如申請專利範圍第11項所述之殼體結構，其中，



六、申請專利範圍

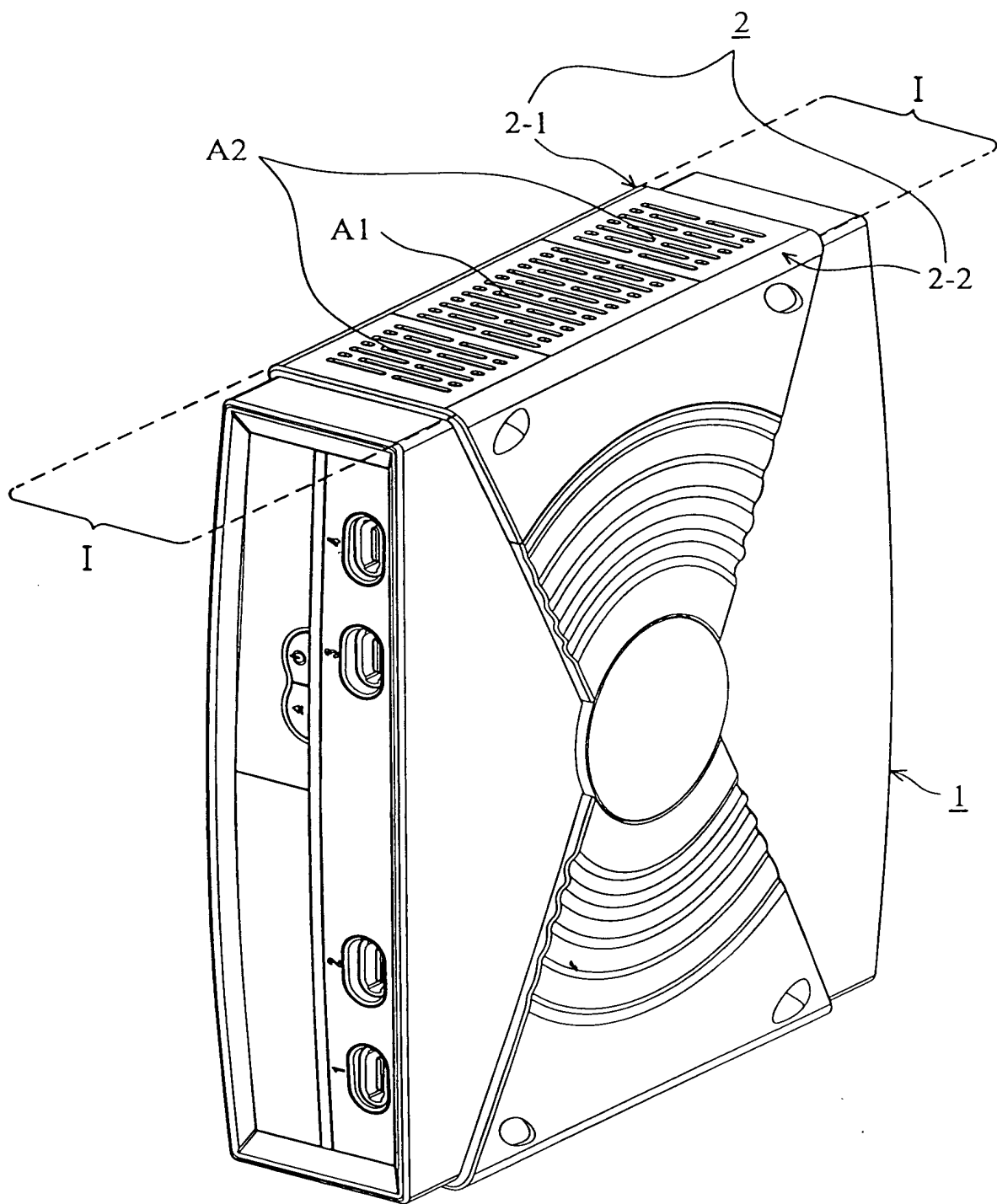
該第一定位部係為一導槽。

14. 如申請專利範圍第11項所述之殼體結構，其中，  
該第二定位部係為一導塊。

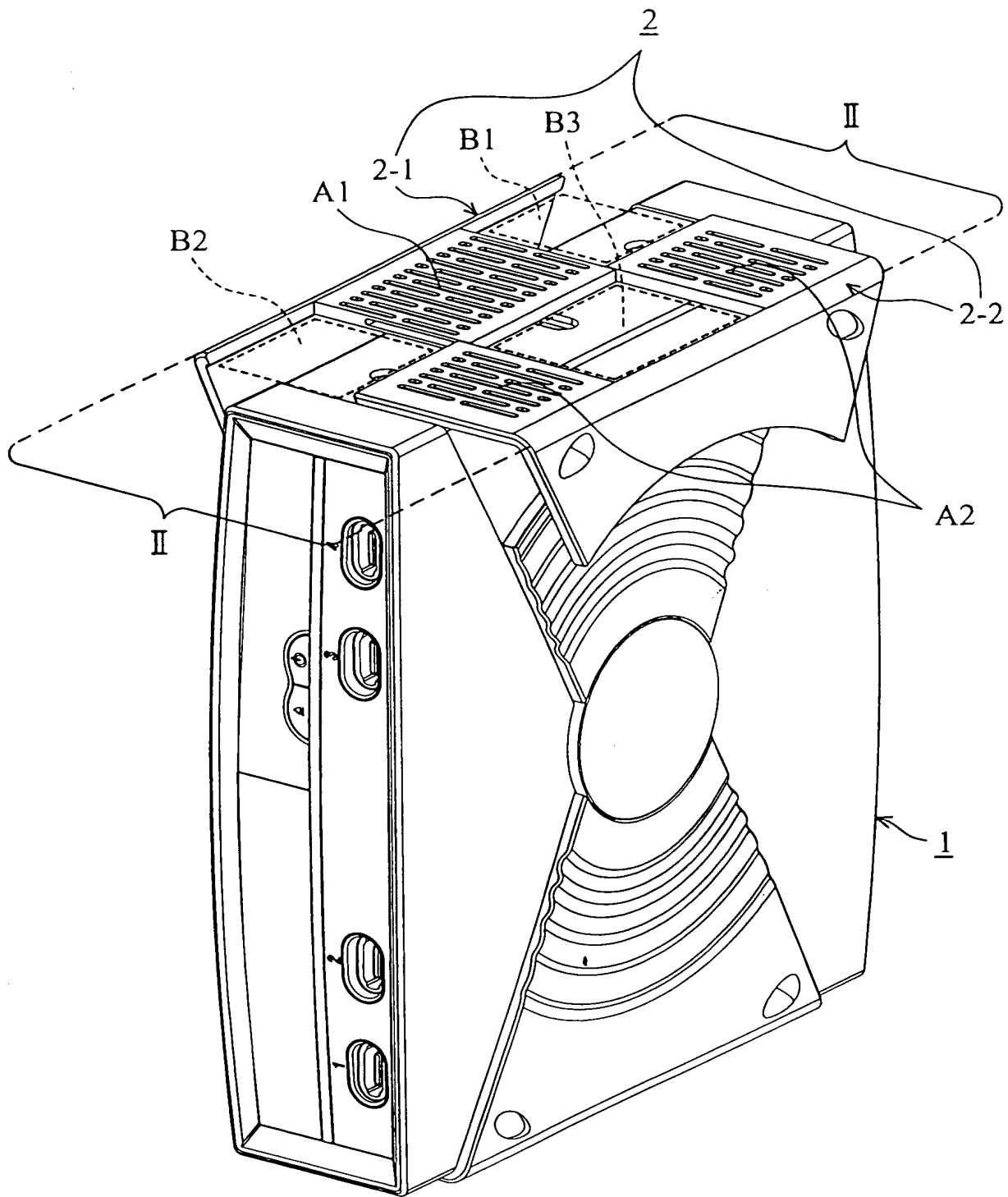
15. 如申請專利範圍第11項所述之殼體結構，其中，  
該第一構件、該第二構件之間係沿著相反方向而由該第一  
位置移動至該第二位置。



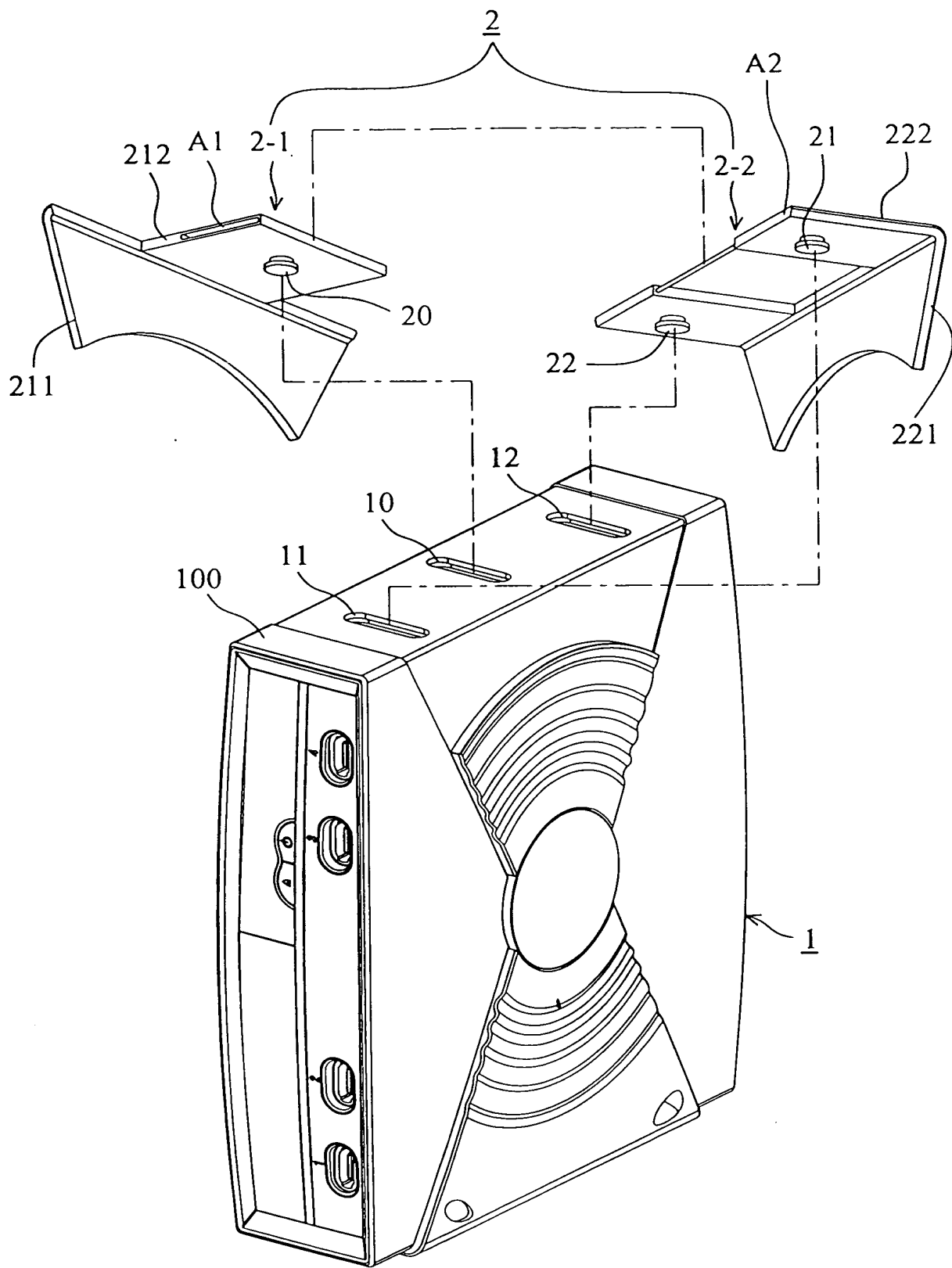




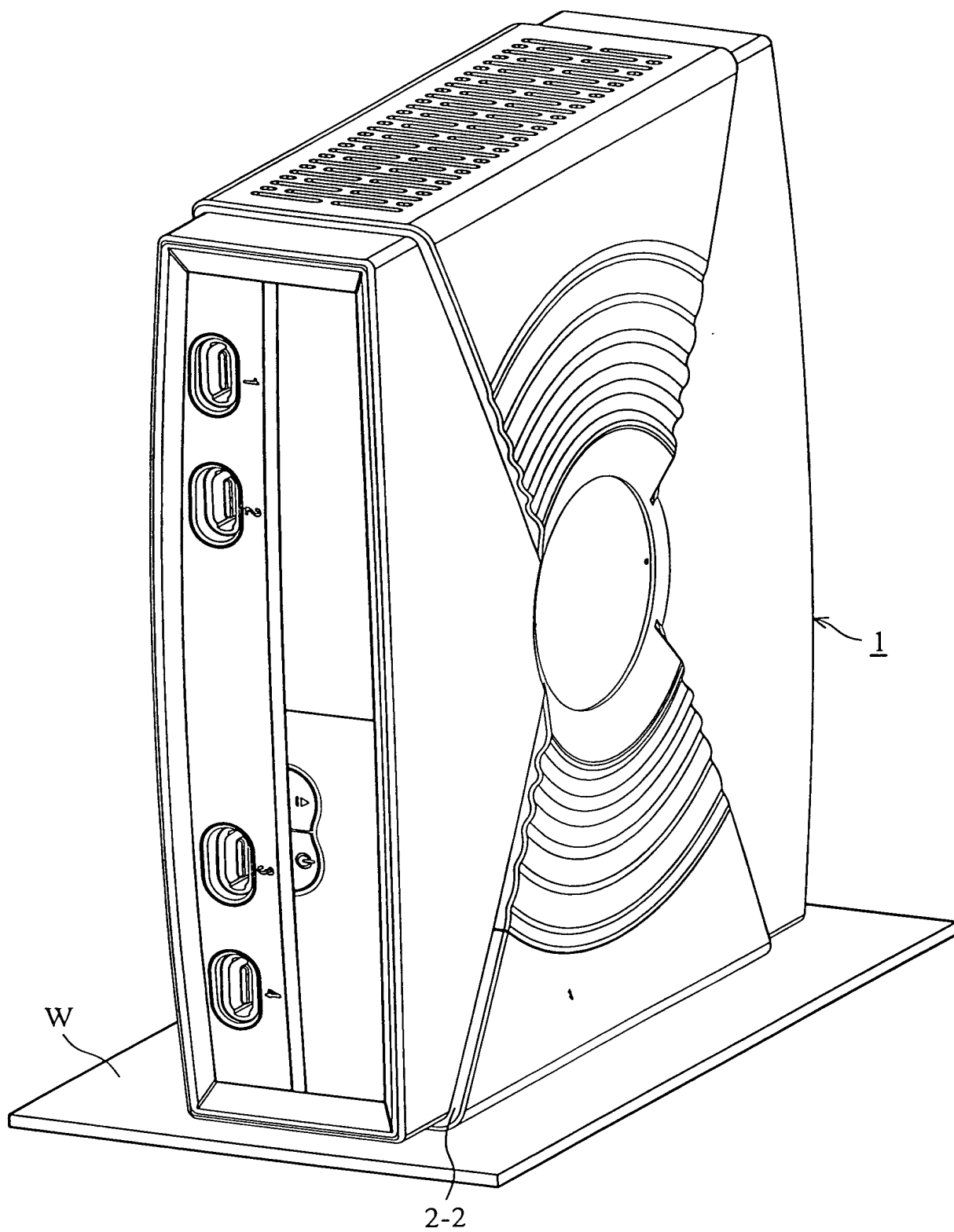
第 1A 圖



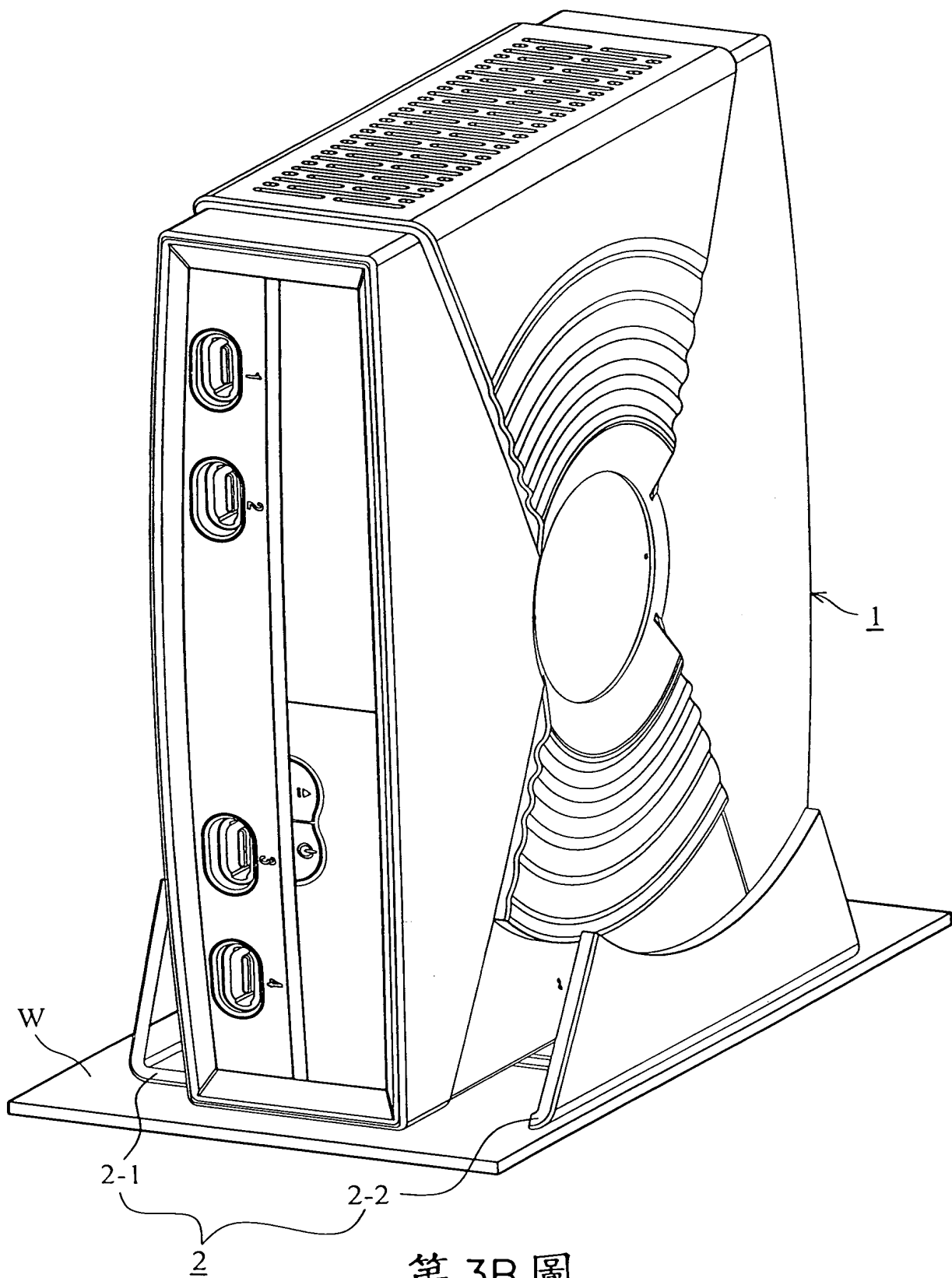
第 1B 圖



第 2 圖

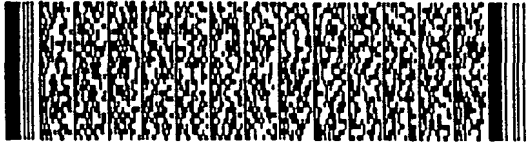


第 3A 圖



第 3B 圖

第 1/14 頁



第 2/14 頁



第 3/14 頁



第 4/14 頁



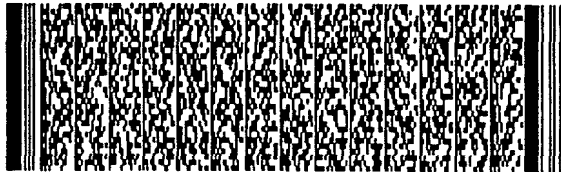
第 5/14 頁



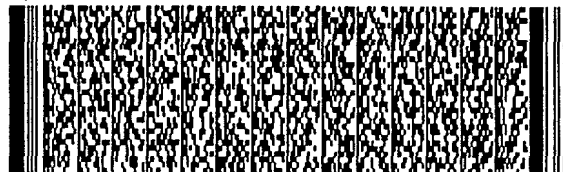
第 5/14 頁



第 6/14 頁



第 6/14 頁



第 7/14 頁



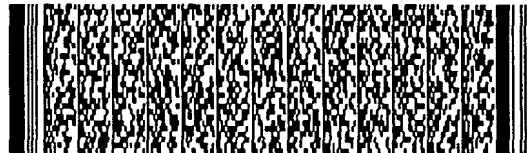
第 7/14 頁



第 8/14 頁



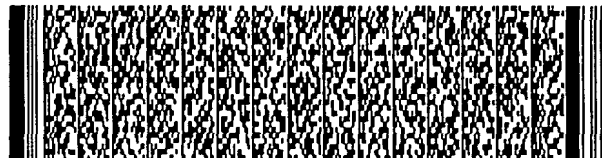
第 8/14 頁



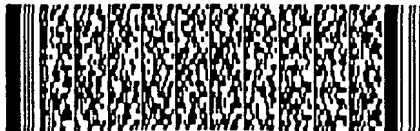
第 9/14 頁



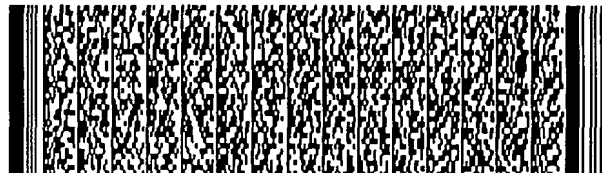
第 10/14 頁



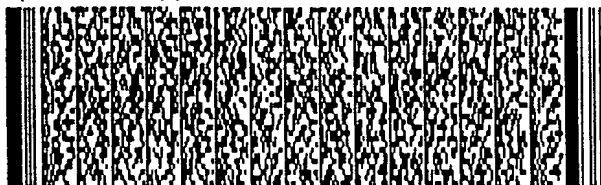
第 11/14 頁



第 12/14 頁



第 13/14 頁



第 14/14 頁

